

	INFORME DE LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS/ NO IMPARTIDOS Y SUS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. INFORME DE MÍNIMOS	Curso Académico: 2019/20
Módulo: Montaje y Mantenimiento de Equipos Ciclo: Sistemas Microinformáticos y Redes		Curso: 1º

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EVAL	U. D.	IMPAR TIDO	CRIT. DE EVALUACIÓN NO IMPARTIDOS 3ª TRIMESTRE (MÍNIMOS EN NEGRITA) (*)	CONTENIDOS NO IMPARTIDOS 3º TRIMESTRE (MÍNIMOS EN NEGRITA) (*)
RA1. Selección de componentes de equipos microinformáticos estándar:	1	1	Sí		
a) Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.			Sí		
b) Se ha reconocido la arquitectura de buses.			Sí		
c) Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, tensiones, potencia, zócalos, entre otros).			Sí		
d) Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores.			Sí		
e) Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la placa base.			Sí		
f) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes.			Sí		
g) Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros).			Sí		
h) Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor.			Sí		
RA2. Alimentación de componentes:	2		Sí		
a) Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente.			Sí		
b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el aparato según la magnitud a medir.			Sí		
c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.			Sí		
d) Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un ordenador personal.			Sí		

e) Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.			Sí		
f) Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales.			Sí		
RA3. Discriminación de placas base y sus componentes:	3		Sí		
a) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el hardware de un equipo.			Sí		
b) Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del microprocesador.			Sí		
c) Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala conexión de componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, suciedad, entre otras).			Sí		
d) Se han sustituido componentes deteriorados.			Sí		
e) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.			Sí		
f) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes.			Sí		
g) Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación).			Sí		
a) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación de software.			Sí		
RA4. Análisis del mercado de componentes de equipos microinformáticos:	2	4	Sí		
a) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el hardware de un equipo.			Sí		
b) Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del microprocesador.			Sí		
c) Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala conexión de componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, suciedad, entre otras).			Sí		
d) Se han sustituido componentes deteriorados.			Sí		
e) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.			Sí		
f) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes.			Sí		
g) Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación).			Sí		

RA5. Aplicación de nuevas tendencias en equipos informáticos:	2	5	Sí		
a) Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-placa base.			Sí		
b) Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las plataformas semiensambladas («barebones») más representativas del momento.			Sí		
c) Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia (HTPC), los chasis y componentes específicos empleados en su ensamblado.			Sí		
d) Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos informáticos empleados en otros campos de aplicación específicos.			Sí		
e) Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como mercado emergente, con una alta demanda en equipos y dispositivos con características específicas: móviles, PDA, navegadores, entre otros.			Sí		
f) Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente alternativa al ensamblado de equipos microinformáticos.	6		Sí		
RA6. Diagnóstico, control y mantenimiento de equipos microinformáticos:		6	Sí		
a) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación de software.			Sí		
b) Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en la placa base.			Sí		
c) Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar.			Sí		
d) Se han realizado imágenes de una preinstalación de software.			Sí		
e) Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes.	7		Sí		
f) Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.			Sí		
RA7. Ensamblado de equipos microinformáticos:		7	Sí		
a) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos microinformáticos.			Sí		
b) Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar.			Sí		

c) Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los distintos sistemas de fijación para ensamblar-desensamblar los elementos del equipo.		Si		
d) Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y elementos de refrigeración en diferentes modelos de chasis, según las especificaciones dadas.		Si		
e) Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades de lectura / grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes.		Si		
f) Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración de la placa base.		Si		
g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del conjunto ensamblado.		Si		
h) Se ha realizado un informe de montaje.		Si		
RA8. Mantenimiento de periféricos:	3	8	No	Mantenimiento de periféricos
a) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión estándar.		No	a) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión estándar.	
b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar.		No	b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar.	
c) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada.		No	c) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada.	
d) Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de imágenes digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones.		No	d) Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de imágenes digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones.	
e) Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con sus posibles aplicaciones.		No	e) Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con sus posibles aplicaciones.	
f) Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, impresión digital profesional y filmado.		No	f) Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, impresión digital profesional y filmado.	
g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos.		No	g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos.	
RA9. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental:	9	No		Riesgos Laborales y protección ambiental.
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.		No	a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.	
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.		No	b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.	

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.		No	c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.	
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.		No	d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.	
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.		No	e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.	
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.		No	f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.	
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.		No	g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.	
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.		No	h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.	

(*) SE CONSIDERA QUE SON LOS QUE HAY QUE PROGRAMAR PARA EL CURSO 20/21

En los ciclos LOGSE (CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA) donde pone Resultados de aprendizaje deben ser Capacidades Terminales